

深切ワンパスフルカット

マイクロ・スライサー

SPG-150



厚物にも対応。



操作盤



計測システム (顕微鏡タイプ)
(OP)



インデックステーブル搭載仕様 (OP)



コンパクトサイズのクーラントタンク
(ニーズに応じて選択できます。)



動力バランス測定器
NB-3000 (OP)

※写真はオプション仕様も含みます。

切断加工機

SGE-52CE₂
SGC-525CE₂

大物ワークにも対応



※ Photo : SGE-52CE₂

● 光学ガラス、セラミック、水晶、薄膜ヘッド、スチール、振動子等を高精度・高能率切断及び溝入れ加工するために開発されました。

- 中型のスライシングマシンをベースにコンパクト化した150型は適切なリブ構造の肉厚鋳物と独自の振動解析技術による、高剛性、低振動設計の為、厚物のワンパスフルカットが可能。(ハイパワー主軸モーターと超精密高剛性スピンドルにより、従来のダイシング・スライシングマシンに比べて、研削抵抗に負けない高能率加工が可能になりました。)
- コンパクトな本体ながら400mmの左右ストロークを確保しており、アライメント用同軸落射式のズーム顕微鏡(オプション)の操作性も良く、必要に応じてCCD及びモニタTVの装着も可能。
- インデックステーブル(オプション)は、最小分解能0.002度と0.0001度の2タイプを用意。入力方式は0.002度はパルスカウント型、0.0001度はサーボタイプ型で任意のパルス数に対して番号で記憶させることが可能。
- 上下、前後、左右の各軸は、独自の精密ガイドを採用しNC制御されています。
- 自社開発のバランスベクターを搭載することにより、砥石軸のダイナミックバランスの修正・監視のみならず、インプロセスで加工状況の監視もできます。
- 電解研削装置(オプション)も取付可能。

特長